



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年8月7日

上場会社名 アピックヤマダ株式会社
コード番号 6300 URL <http://www.apicyamada.co.jp/>

上場取引所 東

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 押森広仁
問合せ先責任者 (役職名) 取締役企画部長 (氏名) 小出 篤

TEL 026-275-2111

四半期報告書提出予定日 平成25年8月13日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
26年3月期第1四半期	1,640	△37.7	△295	—	△281	—	△161	—
25年3月期第1四半期	2,630	2.8	△239	—	△252	—	△253	—

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 6百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 △203百万円 (—%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
26年3月期第1四半期	△13.00	—
25年3月期第1四半期	△20.37	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率	1株当たり純資産
	百万円	百万円	%	円 銭
26年3月期第1四半期	10,737	4,156	38.7	334.37
25年3月期	10,164	4,147	40.8	333.81

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 4,156百万円 25年3月期 4,147百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
25年3月期	—	0.00	—	0.00	0.00
26年3月期	—	—	—	—	—
26年3月期(予想)	—	0.00	—	0.00	0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	4,230	△15.2	△330	—	△310	—	△315	—	△25.35
通期	10,790	24.8	130	—	200	—	190	—	15.29

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
新規 一社 (社名) 、 除外 一社 (社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)

26年3月期1Q	12,969,000 株	25年3月期	12,969,000 株
----------	--------------	--------	--------------

② 期末自己株式数

26年3月期1Q	543,739 株	25年3月期	543,266 株
----------	-----------	--------	-----------

③ 期中平均株式数(四半期累計)

26年3月期1Q	12,425,646 株	25年3月期1Q	12,426,879 株
----------	--------------	----------	--------------

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対するレビュー手続は終了していません。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

(将来に関する記述等についてのご注意)

本資料に記載されている業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P. 2「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. サマリー情報（注記事項）に関する事項	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動	3
3. 継続企業の前提に関する重要事象等	3
4. 四半期連結財務諸表	4
(1) 四半期連結貸借対照表	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第1四半期連結累計期間	6
四半期連結包括利益計算書	
第1四半期連結累計期間	7
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報等)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間における我が国経済は、金融緩和をはじめとした経済政策の期待感により、為替相場の円高是正や株価の回復、および消費マインドや企業業績の改善が見られるなど景気回復の兆しがみられてきました。しかしながら欧州金融不安の長期化や新興国の経済成長の鈍化など、世界経済の下振れリスクが懸念されており、引き続き先行き不透明な状況で推移しました。

当社の需要先である半導体業界においては、パソコンや液晶テレビの需要低迷が続き、これらに関する設備投資が低調に推移する一方、スマートフォンやタブレット端末の需要拡大にともなう半導体の増産用の設備投資が行われました。

このような状況において、当社グループは、平成24年4月にスタートさせた中期経営計画「Innovation 3」に基づき、経営基盤の強化と企業価値の増大を目指し、既存製品の市場開拓強化や、トランスファー・コンプレッション・モールド装置(略称：TCM)、ウェハモールド装置およびLED用装置等の新規製品の拡販を行うと共に、車載系デバイスの関連のパッケージ開発および拡販を積極的に推進いたしました。この他、当四半期連結累計期間において、遊休資産となっていた当社連結子会社のAPIC YAMADA (THAILAND) CO., LTDの工場を売却したことによる譲渡益を121百万円計上しました。

この結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は1,640百万円(前年同四半期比37.7%減)、営業損失は295百万円(前年同四半期は営業損失239百万円)、経常損失は281百万円(前年同四半期は経常損失252百万円)、四半期純損失は161百万円(前年同四半期は四半期純損失253百万円)となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

①電子部品組立装置

電子部品組立装置の受注につきましては、携帯端末機器向け、LED関連および車載系などで設備投資の動きが見られ、TCMなどの新製品を中心に増加しました。一方、売上につきましては、前年度後半の受注実績の影響を受け、当第1四半期は低調に推移しました。

この結果、売上高は910百万円(前年同四半期比48.7%減)、セグメント損失は180百万円(前年同四半期はセグメント損失43百万円)となりました。

②電子部品

主にリードフレームの生産である電子部品については、LED向けおよび一般半導体向け共に回復基調で推移いたしました。価格競争が継続する厳しい環境のなかで、コスト削減など収益の改善に取り組みました。

この結果、売上高は589百万円(前年同四半期比19.2%減)、セグメント利益は21百万円(前年同四半期はセグメント損失42百万円)となりました。

③その他

その他につきましては、リード加工金型およびリードフレーム生産用金型の販売であります。リードフレームを使用する半導体の設備投資につきましては慎重な状況が継続し、低調に推移いたしました。

この結果、売上高は140百万円(前年同四半期比10.8%増)、セグメント利益は7百万円(前年同四半期比45.6%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における総資産は、10,737百万円(前連結会計年度末は10,164百万円)となり、前連結会計年度末と比較して572百万円増加いたしました。これは主に、たな卸資産の増加によるものであります。

(負債)

当第1四半期連結会計期間末における負債合計は、6,582百万円(前連結会計年度末は6,017百万円)となり、前連結会計年度末と比較して565百万円増加いたしました。これは主に、支払手形および買掛金の増加によるものであります。

(純資産)

当第1四半期連結会計期間末における純資産合計は、4,154百万円(前連結会計年度末は4,147百万円)となり、前連結会計年度末と比較して6百万円増加いたしました。これは主に、為替換算調整勘定によるものであります。

なお、これらの要因により、自己資本比率は38.7%(前連結会計年度末は40.8%)となりました。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、平成25年5月14日の「平成25年3月期 決算短信」で公表いたしました第2四半期連結累計期間および通期の連結業績予想に変更はありません。

2. サマリー情報（注記事項）に関する事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動
該当事項はありません。

3. 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループを取り巻く事業環境は厳しい状況が継続しており、前連結会計年度までに2期連続で多額の営業損失を計上いたしました。このような状況により、当社グループが将来にわたって事業活動を継続するという前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。

この状況に対して当社グループは、平成25年度から3年間を対象とした事業構造改革・生産改革・営業改革の3つの改革（Innovation 3）を柱とした「中期経営計画」を策定し、諸施策を実行してまいりました。

この中期経営計画は、①半導体市場において劇的な環境変化に対応できる企業体質を構築し、新たな価値の創出により海外市場を中心にシェアの拡大を図ること、②シリコンサイクルに影響される事業形態からの脱却を目指し、新技術の開発を推進し新たな市場への参入と早期に収益化を図ることを目的として策定いたしました。当社グループは、この中期経営計画の着実な実現をとおして、既存の半導体事業の強化と新規事業の拡大を図り、これによる経営基盤の強化を強い決意で取組んでおります。

また、財務面に関しましては、当面の事業遂行上、十分な手元資金を有しておりますが、引き続きメインバンク等との良好な関係を維持し、安定的かつ弾力的な資金調達を行っていく所存であります。

4. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,217,351	3,164,229
受取手形及び売掛金	1,625,202	1,683,341
商品及び製品	376,115	705,408
仕掛品	951,408	1,096,257
原材料及び貯蔵品	182,998	135,162
その他	500,021	701,202
貸倒引当金	△2,629	△2,987
流動資産合計	6,850,468	7,482,615
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	1,053,445	1,051,134
機械装置及び運搬具（純額）	343,707	333,620
土地	607,899	511,589
その他（純額）	125,102	132,904
有形固定資産合計	2,130,154	2,029,249
無形固定資産	103,490	92,767
投資その他の資産		
関係会社出資金	656,894	715,338
その他	432,837	424,426
貸倒引当金	△8,920	△7,172
投資その他の資産合計	1,080,810	1,132,591
固定資産合計	3,314,456	3,254,608
資産合計	10,164,925	10,737,224
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	998,843	1,504,741
短期借入金	2,800,000	2,825,000
1年内返済予定の長期借入金	288,388	246,388
未払法人税等	11,878	7,299
賞与引当金	53,799	31,403
製品保証引当金	16,603	14,656
その他	313,476	484,088
流動負債合計	4,482,988	5,113,576
固定負債		
長期借入金	607,634	554,462
退職給付引当金	775,900	764,605
その他	150,487	149,955
固定負債合計	1,534,021	1,469,023
負債合計	6,017,010	6,582,600

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	5,837,500	5,837,500
利益剰余金	△972,798	△1,134,285
自己株式	△100,009	△100,066
株主資本合計	4,764,692	4,603,147
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,861	4,767
為替換算調整勘定	△620,639	△453,291
その他の包括利益累計額合計	△616,778	△448,523
純資産合計	4,147,914	4,154,623
負債純資産合計	10,164,925	10,737,224

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日)
売上高	2,630,756	1,640,044
売上原価	2,305,754	1,416,637
売上総利益	325,002	223,407
販売費及び一般管理費	564,139	519,382
営業損失(△)	△239,137	△295,974
営業外収益		
受取利息及び配当金	856	1,263
為替差益	—	9,620
受取技術料	—	16,100
助成金収入	7,329	—
その他	16,510	14,915
営業外収益合計	24,697	41,899
営業外費用		
支払利息	18,673	18,815
為替差損	9,032	—
売上債権売却損	697	—
持分法による投資損失	5,263	7,844
その他	4,533	751
営業外費用合計	38,200	27,412
経常損失(△)	△252,640	△281,487
特別利益		
固定資産売却益	5	121,360
特別利益合計	5	121,360
税金等調整前四半期純損失(△)	△252,634	△160,126
法人税、住民税及び事業税	1,310	1,360
法人税等調整額	△835	—
法人税等合計	475	1,360
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△253,110	△161,487
四半期純損失(△)	△253,110	△161,487

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第1四半期連結累計期間 (自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自平成25年4月1日 至平成25年6月30日)
少数株主損益調整前四半期純損失(△)	△253,110	△161,487
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△8,231	906
為替換算調整勘定	24,031	107,843
持分法適用会社に対する持分相当額	33,408	59,504
その他の包括利益合計	49,208	168,254
四半期包括利益	△203,902	6,766
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	△203,902	6,766

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

I 前第1四半期連結累計期間(自平成24年4月1日 至平成24年6月30日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	1,774,758	729,314	2,504,073	126,683	2,630,756
セグメント間の内部売上高又は振替高	10	—	10	14,466	14,477
計	1,774,769	729,314	2,504,083	141,150	2,645,234
セグメント利益又は損失(△)	△43,392	△42,066	△85,459	4,890	△80,568

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位:千円)

利益	金額
報告セグメント計	△85,459
「その他」の区分の利益	4,890
セグメント間取引高消去	117
全社費用(注)	△158,686
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△239,137

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第1四半期連結累計期間（自平成25年4月1日 至平成25年6月30日）

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

	報告セグメント			その他 (注)	合計
	電子部品 組立装置	電子部品	計		
売上高					
外部顧客への売上高	910,622	589,047	1,499,670	140,374	1,640,044
セグメント間の内部売上高又は振替高	1,188	—	1,188	12,943	14,132
計	911,811	589,047	1,500,859	153,318	1,654,177
セグメント利益又は損失(△)	△180,925	21,233	△159,692	7,120	△152,571

(注) 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リード加工金型及びリードフレーム生産用金型の調達・販売等を行っております。

2. 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び該差額の主要な内容(差額調整に関する事項)

(単位：千円)

利益	金額
報告セグメント計	△159,692
「その他」の区分の利益	7,120
セグメント間取引高消去	78
全社費用(注)	△143,480
四半期連結損益計算書の営業損失(△)	△295,974

(注) 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。